ウェビナー申込書

R&D 支援センターウェビナー【アーカイブ配信】
「半導体パッケージ技術の最新動向＜**FOWLP・SiP・チップレット・CoWoS**＞」
視聴期間：5/19（月）～5/26（月）
受 講 料：55,000 円（税込）

送信先　**Fax：03-3291-5789**　　CMC リサーチ　TEL：03-3293-7053

お名前 例）山田　太郎	
フリガナ 例）ヤマダ　タロウ	
法人名・会社名	
部署名	
郵便番号	
都道府県	
住所 1 市区町村、番地等	
住　　所 2 アパート・マンション名、部屋番号等	
メールアドレス	
電話番号	
FAX 番号	
メルマガ受信可否	□　受信する　　□　受信しない
DM（郵便など）受け取り可否	□　受け取る　　□　受け取らない
興味分野	
お支払い（銀行振込） 予　定　日	年　　月　　日頃
通　信　欄	